

基板品質を評価します

# IPC-TM-650基板品質試験

詳細はこちら [www.oeg.co.jp/env\\_meas/ipctm650.html](http://www.oeg.co.jp/env_meas/ipctm650.html)

**概要** プリント基板表面が導電性物質やイオン残渣で汚染されていると、基板配線や素子のリードが腐食したり、絶縁不良やマイグレーションを引き起こす原因となります。OKIエンジニアリングでは、IPC-TM-650 2.3に準拠した基板清浄度などの試験サービスを提供します。

**特長**

- 基板清浄度の規格試験サービスを提供します
- 清浄度の調査のみでなく、故障解析や劣化調査など、様々なニーズにお応えします

## IPC-TM-650 2.3とは

電子機器の生産、組立てにおいて、質の高い最終製品を生産し、市場での競争力を維持するためには、生産工程全体で品質を徹底させる必要があります。



IPC（米国電子回路協会）では、電子製品の設計、購買から組立てにいたるまで、高い品質と信頼性、一貫性を確保できる標準（試験方法）を提供しています。その中で、プリント基板の品質基準について記載されているのが、IPC-TM-650 2.3規格です。

- ◎ ご依頼が多い試験
- 2.3.25D 基板清浄度測定（電気伝導度）
  - 2.3.28B 基板清浄度測定（イオンマトグラフ）
  - 2.3.35C フラックス中のハロゲン化物含有量測定

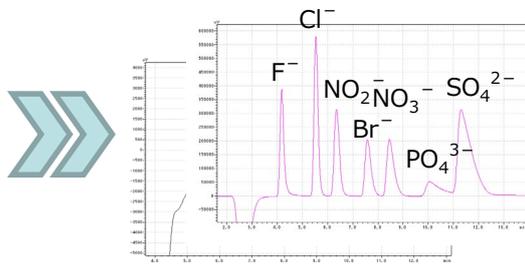


# 実施例

## 事例1 IPC TM650 2.3.28 基板清浄度測定 (イオンマトグラフ)



### 分析項目



アニオン：フッ素イオン・塩素イオン・  
亜硝酸イオン・臭素イオン・  
硝酸イオン・リン酸イオン・  
硫酸イオン  
カチオン：リチウムイオン・ナトリウムイオン・  
アンモニウムイオン・カリウムイオン・  
カルシウムイオン・  
マグネシウムイオン

有機酸：酢酸イオン・  
アジピン酸イオン・  
ギ酸イオン・  
グルタミン酸イオン・  
メタンスルホン酸イオン・  
リンゴ酸イオン・  
コルク酸イオン・  
フタル酸イオン

## 事例2 IPC TM650 2.3.35C フラックス中のハロゲン量測定

### IPC-TM-650 2.3.35C

フラックスまたはフラックスを含有するリダ-ハ°-スト等を対象とし、フラックス中のハロゲン量の測定を行います。  
塩素イオン(Cl)、臭素イオン(Br)含有量の合計を、塩素(Cl)含有量(%)に換算した値として報告します。

リダ-ハ°-スト等のフラックス含有量、液状フラックスの固形分含有量は、2.3.34により別途測定します。

### IPC-TM-650 2.3.34C

<フラックスの固形分含有量測定>

質量を測定したフラックスを乾燥機で加熱し、冷却後の質量との差から固形分含有量を求めます。

### IPC-TM-650 2.3.34.1B

<フラックス含有量測定>

質量を測定したリダ-ハ°-スト等のはんだ成分を溶融し、フラックス成分と分離し後の質量から含有率を求めます。

